

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

## 泰晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-004

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	兴业证券、东方基金、同泰基金、广东正圆私募基金、上海盘京投资、长盛基金、东吴基金、中华联合保险、九泰基金、兴证资管、深圳私享股权投资基金、浙商资管、君康人寿、上海磐厚投资、长城财富保险、厚润德投资、华源证券、上海证券、国海证券等 27 人
<b>时间</b>	2025 年 5 月 6 日 15:00-16:00
<b>地点</b>	董秘办公室
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事会秘书：黄晓辉女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p><b>一、业绩介绍情况</b></p> <p>2024 年，伴随消费类电子市场的改善以及 AI、电动/智能汽车、光通信等领域的快速发展带动了石英晶体频率元器件需求的上升，但需求结构分化及同质化竞争，产品价格下滑。在严峻的外部环境下，公司深耕石英晶体频率元器件，以技术降本、质量降本为主要抓手，在提质增效、管理提升上下功夫，主动适应终端市场需求变化，巩固核心产品优势，保持优势产品技术与市场竞争力，加快高附加值产品布局，以市场和客户为中心，稳步推进新行业、新应用领域产品特别是低功耗、高基频、高稳定性、钟振类、高可靠性产品研发及品类扩充，把</p>

握相关应用领域结构性增长机会，不断提升公司综合竞争力。

业绩方面，公司主动参与市场竞争，不断提升市占率。2024年，公司实现营业收入 8.2 亿元，同比增加 3.55%；实现归母净利润 8,758.09 万元，同比减少 13.55%。2025 年一季度，公司实现营业收入 2.00 亿元，同比增加 10.09%；实现归母净利润 869 万元，同比下降 71.52%。

2024 年，公司持续加大研发投入，全年研发费用达 4,868 万元，较上年同期增长 33.05%，以进一步巩固自身竞争力，形成较强的拳头产品及核心工艺技术，与此同时，研发费用同比增长 1,100 万，对 2024 年度归母净利润产生影响。

2024 年，公司直面竞争，主动调整部分产品价格，另新扩有源及车规产线、CNAS 实验室、高基频光刻车间等落地，新投产线陆续接受重点客户验收定点，产能尚未释放，固定资产投资增多带来的费用折旧增大，人力成本增长，成本端上涨，影响毛利率，同时，2024 年 9 月，公司施行员工持股计划，对优秀人才进行激励，股份支付费用从 2024 年四季度开始计提，影响 2024 年四季度净利润 543 万，2025 年一季度 650 万，对利润产生一定影响，但这些成本，都是公司未来高质量发展布局的重要安排。

## 二、未来展望

1、行业格局正在出清，优胜劣汰的演化趋势下，将更有利于公司提升市占率。晶振行业竞争愈发激烈，市场正经历加速出清的过程。未来随着行业竞争的加剧，部分中小企业将因技术瓶颈、资金压力等问题逐渐退出市场，大客户在导入过程中也将考虑产品质控能力、供应稳定性，市场份额将向头部企业集中。在这一背景下，泰晶科技作为龙头企业，凭借领先的技术积累、完善的产品布局以及优质的客户资源，将充分受益于行业格局的优化。

2、高端化投入将迎来战略收获期。2024 年公司持续加大研发

投入，积极推进高端化战略布局，并取得了显著成效。在全域产品布局中，巩固 kHz 晶振、RTC 领域技术优势和市场竞争优势；继续推动微小尺寸、超高基频全产业链的自主可控，在 2024 年超高频光刻车间扩产基础上，100M 以上面向 6G、光模块、服务器等应用场景配套稳定量产，产出良率和产销量逐步提升；2025 年，继续加大车规产线投资，推动有源产品、XO 产线的全面投产，提高高精度、高可靠性和高稳定性产品产能及占比，提升高毛利率产品产出效益比。

3、2025 年，围绕大客户发展战略，抢占关键市场，构筑竞争壁垒。在物联网、移动终端、工业控制、电力能源等市场，利用国内在成本控制、供应链本地化服务和快速响应优势，进一步提升行业头部客户的市场渗透，聚焦高价值高可靠性车规级晶振、工业级 XO 差分振荡器，服务器和数据中心对超高基频、高精度晶振的需求增长，以及卫星导航、智能物联、光通信等对高稳定性晶振需求，配套主流芯片厂商升级与日系保持技术水平的一致性，实现从国产替代到全球配套，共建生态场景落地。

4、新兴市场多点开拓。AI 的兴起为晶振市场带来了新的机遇。端侧 AI 的发展，使得各类 AI 终端对晶振需求大增。相关应用如智能驾驶、AI 眼镜、AI 玩具、算力服务器、人形机器人等都将为公司产品带来新的消费场景。公司作为全球少数具备算力芯片配套能力的晶体厂商以及全域产品生产能力，产品具备先发优势，同时，6G、北斗、低空飞行器等新兴市场也为晶振行业带来了新的发展方向，公司已落地方案在部分场景中实现应用。公司有望在新兴技术领域卡位和国产替代加速，凭借技术优势和成本优势逐步承接日台系产能转移。

### 三、问答环节：

1、2024 年公司车规业整体的表现如何，战略投入期具体遇到了哪些困难，后续如何展望？

答：1) 在客户端车规级晶振与芯片同列“核心器件”序列。时钟信号是电路系统中频率最高，边缘最陡的信号，最容易受到干扰。晶振出问题将影响整个系统，所以客户在选择上会更慎重，对晶振厂商的选择验证周期会更严苛；

2) 车规级晶振的难度本质是在高精度与极端环境下实现零缺陷的工业化，其生产需突破材料极限（如耐高温石英晶体）、工艺极限（零缺陷要求）和可靠性极限（如 15 年寿命），同时满足严苛认证与供应链管理。全球仅少数企业能稳定供应车规晶振，行业壁垒极高，这也是车规晶振价格昂贵、验证周期长的关键因素；

3) 大客户要求非常多，且很多是个性化需要，客户对物料供应、质量、价格等各方面的需求，双方需要通过足够的了解，建立足够的信任后达成合作；出于产品的超高可靠性要求，汽车及汽车电子客户不会轻易去变更物料或者供应商，前期导入要求非常高，导入周期非常长；而随着现在汽车智能化、电气化的高速发展以及日渐加剧的竞争，主机厂和 Tier1 企业为了有效控制成本、提高开发速度，越来越多的选择了平台化的方案和设计，一旦实现批量供应就很难被替换。

4) 公司在车规方面主要有以下发展布局：

（1）成立汽车电子事业部，建成车规产线及 CNAS 实验室，扩大车规级晶振生产规模，进一步满足客户需求，全系列车规级晶振已顺利通过了权威机构的 AEC-Q200/Q100 认证，同时，车规专线的建成极大提升公司客户导入的进度，缩短审厂和体系认证的时间；

（2）车规级产品已开发 2,000 余款料号，并持续研发升级，产品从无源晶振拓展到有源晶振，在客户认证上，经过前些年公司产线的建设和料号的开发沉淀，已在车身域、智驾域、座舱域、动力域和底盘域等多场景全方位加快市场导入；

（3）重点针对国产芯片平台完成相应设计工作，车规级产品从芯片厂商认证到主机厂逐步导入，公司超小尺寸、难度更高，

技术、工艺更为复杂的 76.8MHz 高频热敏晶体谐振器通过高通车规级 5G 平台 SA522 和 SA525 认证，推动公司在主流芯片车规级平台认证的新高度；

（4）体系的进一步完善，提高品控管理能力，达成客户“零缺陷”要求，客户导入速度加快，质量过硬、类型丰富的车规级晶振产品，已获得了大量的国际、国内知名主机厂和 Tier1 企业的项目定点。车规级软硬件质量同时提升，为车规级晶振从量变到质变打下坚实基础。

## **2、如何看待后续行业出清的趋势？**

答：公司将继续贯彻占市场、保交付、保销量的经营发展策略，以技术创新和产品差异化、多样化，进一步提升市场竞争力。未来市场需求将呈现结构化升级，即更小尺寸、更高频率、更稳定性产品需求量的提升。一方面，增加通用料号的竞争，出清部分供给产能，发挥成本优势，保障高品质产品的销量，让国内晶振市场能有更好的供应环境，特别是当前国内大客户量级的增长，泰晶先拔头筹保障好国产品牌的产品品质和售后。另一方面，保障高端料号的研发，研发端持续配合，确保高端需求的稳定持续配套供给。

## **3、上游基座等涨价对公司毛利率有何影响？**

答：部分基座供应商有涨价，原材料的涨价对于行业来说属于正常的现象，公司与重要供应商保持着密切的互动，公司具备优于同行的规模优势和先进制程能力及产品成本端的管控优势，部分产品料号的基座涨价分摊到单个产品上的单位成本影响可控。按以往经验，上游原材料涨价会逐步传导至客户端，但需要一定的过程。

## **4、如何展望后续毛利率走势？**

答：公司新扩有源产线及车规产线等，小尺寸、高基频、高稳

定性、高精度等高附加值产品结构调优，叠加光刻工艺高壁垒产品增量上行，公司也将把握 6G、光通讯、AI、低空飞行等新兴市场带来的发展机遇，高毛利率产品占比有望逐步提升。

**5、服务器、交换机等领域国产诉求比较高，主要是哪些客户的哪些相关产品，收入量级和增速如何展望？**

答：在中美关系博弈、国家自主可控的长期需求下，包括服务器、交换机等对国内的供应链需求明显的增多，公司适配服务器、交换机、路由器等国产需求，高频差分振荡器、高稳定性高精度产品产销量提升，在新业务、新产品上贡献价值增量，终端客户及高端产品占比提升。面对国产化诉求，公司积极响应服务器、云厂、AI 应用等国产化更高频率更高精度的产品需求，精准发力，更高基频、更高精度国产品振有望得到广泛适配与应用。

**6、如何看待光模块市场，光模块中晶振的用量和价值量能有多少？**

答：2025 年预计是 400G 光模块元年，100G、200G 的越来越少，400G、800G 的会增多。公司针对光通信 200G、400G、800G 市场推出了高基频、高精度、低相噪 CMOS、LVDS 差分输出时钟解决方案，随着光模块传输速率升级，对应使用超高频、差分时钟产品，在技术上提出更高性能匹配要求。随着终端全光网络的普及及 AI 人工智能对算力的要求增加，公司高稳产品将形成很好的增长态势，从而带来新的增长点。根据频点和性能参数来定义价格，价值量相对较高。

**7、AI 端侧应用落地会给公司带来哪些新的机会？在 AI 相关应用领域，公司有典型的客户或实质认证吗？**

答：AI 推动移动终端智能化，相关应用如 AI 眼镜、AI 手机等渗透量显著提升，带动高性能晶振用量同步提升，且相比于传

	<p>统终端，AI 终端或将具备更多接口、传感器，无线 SOC 实现“连接+处理”。公司作为 AIoT 上游元器件制造商，搭载蜂窝类及无线通讯模组主芯片方案，并作为全球少数具备 AI 算力芯片对智能硬件性能提升及低功耗要求配套能力的晶体厂商，公司的高基频、超精度、小尺寸产品具备先发优势、将成为国产替代产业链相关晶振选型的首要参与者和受益者。</p> <p><b>8、如何看待硅晶振替代石英晶振的可行性？</b></p> <p>答：硅晶振无法替代石英晶振，替代的成本比较高。第一，硅晶振物理特性天然的 Q 值不好，能耗较高，频率短稳差，易产生温漂，在 5G 通信中误码率高，从而影响使用体验感。硅晶振的应用原理是软件定义硬件，就材料本身性质而言，硅晶振与石英晶振相比，频率的高 Q 值及稳定性存在本质差距。第二，大家关注到应该是因为海外终端品牌在考虑使用硅晶振，但硅基材的晶振在一定频率上，消耗的功率比石英晶振大，在抖动和延迟上的表现比石英晶体弱。市场上选用硅基材晶振的方案比较少，客户不敢轻易采纳。因为定了选型后，后续交付的问题会比较大。目前硅晶振的路线并没有被广泛采纳。综合来看，硅晶振受到性能局限（低 Q 值、高能耗）与成本问题制约其普及。石英晶振凭借成熟工艺和性能优势仍是主流。</p>
附件清单(如有)	
日期	2025 年 5 月 6 日